

广东省发展和改革委员会

广东省发展改革委关于组织申报半导体及 集成电路公共服务平台和创新 平台项目的通知

省教育厅、科技厅、国资委，各地级以上市发展改革局（委），各有关单位：

为落实国家及省关于促进集成电路产业发展的决策部署，提升产业核心竞争力，根据《广东省加快半导体及集成电路产业发展的若干意见》（粤府办〔2020〕2号），拟安排省级财政资金支持公共服务平台和创新平台项目建设。现将有关事项通知如下：

一、重点支持方向

重点支持企业、事业单位、高校、科研机构等法人实体投资建设的半导体及集成电路领域公共服务和创新基础设施，主要包括：

（一）芯片设计服务平台和创新平台。芯片设计服务平台，向社会提供 EDA 工具服务、MPW（多项目晶圆加工）服务、设计外包服务、测试验证服务、IP 分析交易服务、人才培养服务等。芯片设计工具软件研发和测试平台，开展 EDA（电子设计自动化）工具软件研发测试，开展 EDA 云上架构和应用 AI 技术研发，开

展 TCAD、封装 EDA 工具开发等。芯片设计研发、模拟仿真和测试平台。开展底层算法与架构技术研发，开展通用芯片、专用芯片研发、模拟仿真和测试。

（二）芯片产品检测认证平台。向社会提供部件及终端产品模拟、测试验证、产品质量测评、环境适应性评价、安全可靠认证等服务。

（三）芯片生产制造关键技术研发、中试和测试平台。开展 FinFET 特色工艺制程、先进工艺制程开发，探索开展 FDSOI 等新技术路径开发。

（四）先进封装测试研发和工程化验证平台。开展晶圆级封装、系统级封装、凸块、倒装、硅通孔、面板级扇出型封装、三维封装、真空封装等先进封装技术，以及脉冲序列测试、MEMS 探针、IC 集成探针卡等先进晶圆级测试技术开发，开展超高速光通信核心器件与模块封测技术开发等。

（五）关键材料与器件研发及工程化验证平台。开展氮化镓、碳化硅、氧化锌、氧化镓等化合物半导体材料、器件和模块的开发，开展氟聚酰亚胺、光刻胶等电子化学品材料以及纳米级陶瓷粉体、微波陶瓷粉体等元器件关键材料研发。

（六）芯片生产制造关键设备及零部件研发及工程化验证平台。开展光学和电子束光刻机关键部件、先进封装技术专用设备研发，开展缺陷检测设备、激光加工设备、半导体器件巨量组装设备等整机设备研发，以及高精密陶瓷零部件、射频电源、高速

高清投影镜头等设备关键零部件研发。

（七）新一代半导体及集成电路综合研发平台。围绕工具软件、芯片架构、芯片设计、特色工艺制程、半导体新材料、生产设备核心部件等环节，开展关键核心技术攻关，积极开展混合集成、异构集成等技术研发，加强多种技术路线探索。

一个平台项目可包括上述多个方向。

二、申报条件

（一）承担单位应在广东省内注册，具有独立法人资格。

（二）已被有关部门认定为国家级、省级平台。

（三）项目建设周期不超过三年，已完成的固定资产投资权属清晰，形象进度不超过 50%。

（四）建设项目要有明确可行的发展思路和建设目标，投资方案合理，管理和运行机制规范。

（五）项目申报时应完成项目备案等立项手续，同时加快环评、城乡规划、用地审批等工作进度，确保投资计划下达前完成前期工作。

（六）项目承担单位要对申报材料的真实性负责，并出具承诺书，承诺其所报材料尤其是投资规模的真实性，承担因上报虚假信息造成的相应后果，如取消申报资格、纳入失信名单等。

三、申报程序

（一）编制资金申请报告。资金申请报告应包括以下内容：承担单位基本情况、国家级省级平台认定文件、项目投资建设方

案、固定资产投资明细、项目资金筹措方案、自有资金来源凭证、申请补助资金额度、补助资金使用计划、与申报投资规模相匹配的绩效目标表等。

(二) 组织申报。项目承担单位为中央直属单位、省属单位的，可直接向省发展改革委申报；项目承担单位有其他类型的，由各地级以上市发展改革部门汇总后向省发展改革委申报。

四、支持方式

省发展改革委将组织专家或委托有关单位，综合采用书面评审、答辩、考察等方式进行评估，对通过评估的项目，视年度资金安排给予支持。

五、申报时间

请于 2020 年 11 月 6 日前将正式申报文件和项目资金申请报告及有关资料一式三份（含电子版一份）报送至省发展改革委。



（联系人及电话：黄钦、虞佳杰，020-83138617、83138698）

公开方式：主动公开

3183